



# Orbotech Diamond™ 10W

最佳防焊直接成像



## Orbotech Diamond 10W

Orbotech Diamond 10W 是高能高阶的防焊直接成像 (DI) 解决方案，专为应对白色防焊PCB应用的独特挑战而设计（例如 miniLED 背光模组）。经业界验证的 Orbotech Diamond 10W 是用于白色防焊系统的专用机型，即使是最复杂的设计也可实现高品质成像及高产能。

采用 KLA 专利的 SolderFast™ 技术，Orbotech Diamond 10W 提升了白色防焊直接成像的能力，在加强了成像精确性及品质的同时减少了整体拥有成本 (TCO)。



### 优势

#### 高品质成像

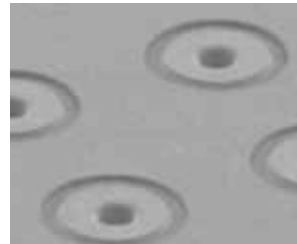
- 白色防焊的高品质成像
- 多波长可实现高品质侧壁及优异的表面品质
- 显著减少白色防焊的底切
- 高景深 (DOF) 适用于高低差大的表面

#### 高产能，快速产出

- 专利高能量照明光源
- 一次扫描成像，单次曝光即可完成全板均匀成像
- 双台面传输机制优化成像时间
- 实时靶点识别及捕捉功能

#### 卓越的成像精度

- 对位精度高达  $\pm 10\mu\text{m}$
- 高阶涨缩模式和算法，克服板材变异



高品质防焊成像



高对位精度



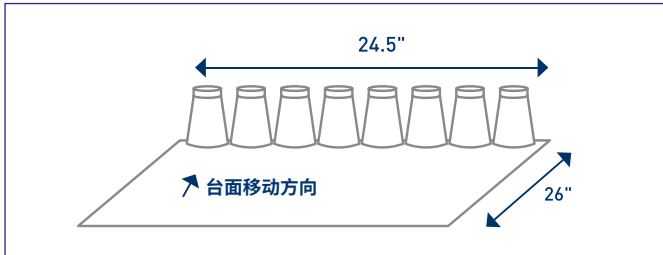
Orbotech Diamond 10W  
白色防焊桥，最小底切



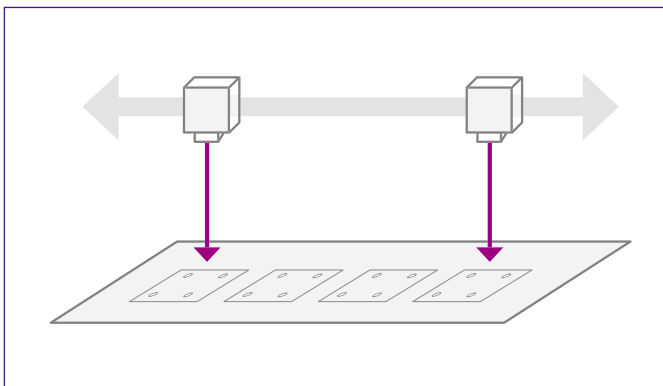
其他防焊直接成像解决方案  
白色防焊桥，明显的底切



## 高品质成像和快速产出

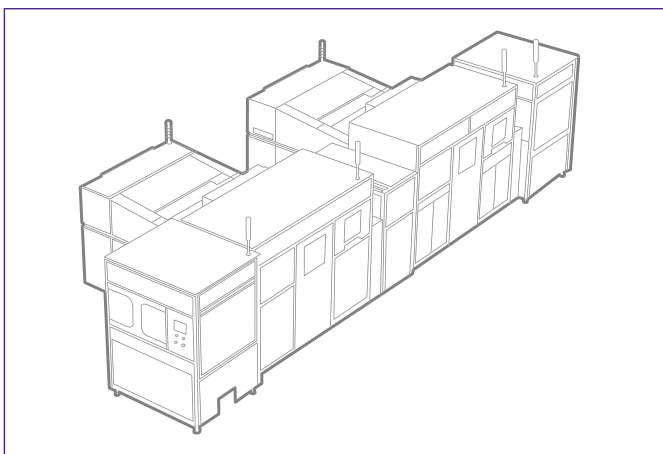


一次成像实现快速产出，成像均匀且没有拼接问题

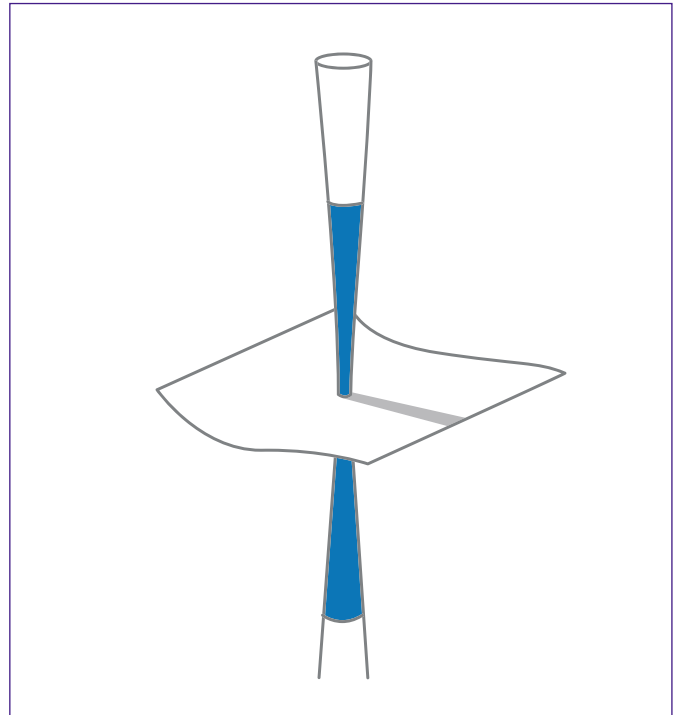


实时靶点识别及捕捉

## 高产能量产解决方案



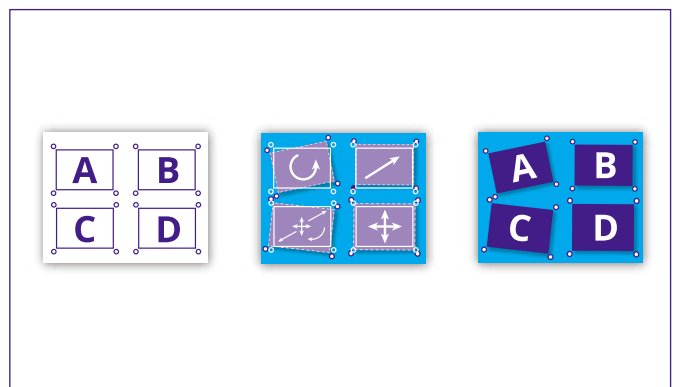
支持自动化



高景深 (DOF) 适用于高低差大的表面

## 卓越的成像精度

高阶涨缩模式和算法可以克服具有挑战性的板子变形，包括自动涨缩，局部涨缩及非线性涨缩



CAM 数据

板子

图像

## 规格

最小开窗*	100μm
最小防焊桥*	75μm
对位精度**	±10μm
最大板子尺寸 (X/Y)	25" x 26" (635mm x 660mm)
最大曝光尺寸 (X/Y)	24.5" x 26" (622mm x 660mm)
曝光能量范围	50-2,200mJ/cm <sup>2</sup>
尺寸	高: 1,960mm 深: 3,226mm 宽: 1,900mm
重量	5,000Kg
应用	白色防焊曝光

\* 取决于防焊油墨类型及制程

\*\* 所有值均为 3σ

- 上述规格如有变更, 恕不另行通知。

## KLA 支持

保持系统生产力是 KLA 良率优化解决方案不可或缺的一部分。包括系统维护、全球供应链管理、降低成本和减少报废、系统迁移、性能和生产率提升以及转售认证设备。

KLA Corporation

[www.orbotech.com/pcb](http://www.orbotech.com/pcb) | [www.kla.com](http://www.kla.com)

Rev 4.1\_4-11-2022

©2022 KLA 公司。所有品牌或产品名称可能为其各自公司的商标。KLA 保留在不另行通知的情况下更改硬件和/或软件规格的权利。